

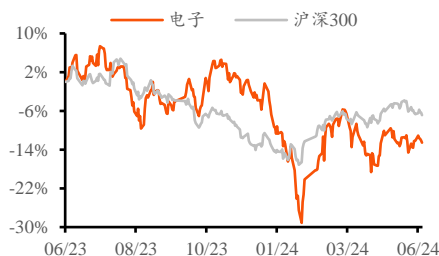


Gaudi 3 芯片售价公布，英特尔或重视玻璃基板封装 ——电子行业周报（2024.06.03-2024.06.07）

增持(维持)

行业： 电子
日期： 2024年06月11日
分析师： 陈宇哲
E-mail: chenyzhe@yongxingsc.com
SAC 编号： S1760523050001

近一年行业与沪深 300 比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

相关报告：

- 《康宁推进玻璃基板工艺，台积电称 3D 封装日趋重要》
——2024 年 06 月 03 日
- 《英伟达 24Q1 业绩亮眼，GB200 或提前导入 FOPLP》
——2024 年 05 月 28 日
- 《微软或开放自研芯片，SK 海力士与台积电合作 HBM》
——2024 年 05 月 20 日

核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

玻璃基板：英特尔或将瞄准玻璃基板的面板级扇外型封装技术，玻璃基板产业或将加速发展。英特尔携手 14 家日企合作，租用夏普闲置的 LCD 面板厂作为先进半导体技术研发中心，或将瞄准玻璃基板的面板级扇外型封装技术。我们认为，玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受益。

铜连接：GB200 采用铜缆连接，预估 2024 年出货量为 42 万片，相关产业链或将受益。GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆。GB200 在 2024 年预估出货量为 42 万片，2025 年将达到 200 万片。我们认为，GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。

先进封装：日月光推出先进封装新平台，相关产业链有望持续收益。根据科创板日报报道，日月光锁定 AI 应用，推出 powerSiP™ 创新供电平台，减少信号和传输损耗，该技术强化日月光 3D 封装技术及未来营运表现，有助提升其在 AI 市场的份额。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

算力芯片：英特尔 Gaudi 3 AI 芯片售价公布，算力芯片产业链有望持续收益。英特尔在 2024 台北国际电脑展上，透露 Gaudi 3 AI 芯片售价为 15650 美元，基本上是英伟达 H100 芯片的一半。新款 Gaudi 3 与英伟达 H100 相比训练性能提高了 170%，推理能力提高了 50%，效率提高了 40%。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

市场行情回顾

本周（6.3-6.7），A 股申万电子指数下跌 0.46%，整体跑输沪深 300 指数 0.3pct，跑赢创业板综指数 3.39pct。申万电子二级六大子板块涨跌幅由高到低分别为：半导体(1.21%)、元件(0.83%)、电子化学品 II(-1.53%)、消费电子(-2.06%)、光学光电子(-2.49%)、其他电子 II(-5.7%)。从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势，海内外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾电子(3.88%)、道琼斯美国科技(3.59%)、费城半导体(3.2%)、纳斯达克(2.38%)、恒生科技(2.21%)、申万电子(-0.46%)。

投资建议

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等；

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份；

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。

风险提示

中美贸易摩擦加剧、下游终端需求不及预期、国产替代不及预期等。

正文目录

1. 本周核心观点及投资建议	3
2. 市场回顾	5
2.1. 板块表现	5
2.1. 个股表现	7
3. 行业新闻	8
4. 公司动态	10
5. 公司公告	11
6. 风险提示	12

图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (6.03-6.07)	5
图 2: A 股申万二级行业涨跌幅情况 (6.03-6.07)	5
图 3: A 股申万三级行业涨跌幅情况 (6.03-6.07)	6
图 4: 海内外指数涨跌幅情况 (6.03-6.07)	6

表目录

表 1: 电子行业 (申万) 个股本周涨跌幅前后 10 名 (6.03-6.07)	7
表 2: 电子行业本周重点公告 (6.03-6.07)	11

1. 本周核心观点及投资建议

核心观点:

玻璃基板：英特尔或将瞄准玻璃基板的面板级扇外型封装技术，玻璃基板产业或将加速发展。根据科创板日报援引中国台湾经济日报报道，英特尔携手 14 家日企合作，租用夏普闲置的 LCD 面板厂作为先进半导体技术研发中心，锁定后段封装领域，加码先进封装。业界认为，英特尔采用面板厂房作为基地，或将瞄准玻璃基板的面板级扇外型封装技术。我们认为，玻璃基板或将适合 HPC、AI 领域的芯片，相关产业链有望持续受益。

铜连接：GB200 采用铜缆连接，预估 2024 年出货量为 42 万片，相关产业链或将受益。根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200 采用 72 个 Blackwell GPU 全互连的 NVLink 技术，拥有超过 2 英里的 NVLink 铜缆，展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省 20 千瓦的电力。根据科创板日报报道，从 CoWoS 先进封装产能研判，2024 年下半年估计将有 42 万颗 GB200 送至下游市场，2025 年产出量上看 150 万至 200 万颗。我们认为，GB200 出货顺利或将提振铜连接相关器件需求，相关产业链有望持续受益。

先进封装：日月光推出先进封装新平台，相关产业链有望持续收益。根据科创板日报报道，日月光锁定 AI 应用，推出 powerSiP™ 创新供电平台，减少信号和传输损耗。日月光表示，powerSiP™ 技术创新可使电流密度增加 50%，并将布线功耗从 12% 降低至 6%，相较于传统并排配置的布线功耗降低了 50%。业界认为，此技术直接对准数据中心效能和功耗改进要求。高效能运算（HPC）对于芯片需求，已由制程微缩转向封装堆叠，该技术强化日月光 3D 封装技术及未来营运表现，有助抢攻覆盖范围不断扩大的 AI 市场规模。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有望持续受益。

算力芯片：英特尔 Gaudi 3 AI 芯片售价公布，算力芯片产业链有望持续收益。根据 IT 之家报道，英特尔在 2024 台北国际电脑展上，透露 Gaudi 3 AI 芯片售价为 15650 美元，基本上是英伟达 H100 芯片的一半。英特尔官方介绍称，新款 Gaudi 3 与英伟达 H100 相比训练性能提高了 170%，推理能力提高了 50%，效率提高了 40%。英特尔全新 Gaudi 3 AI 加速器采用 5nm 工艺打造，FP8 性能是上一代产品的两倍，BF16 性能是上一代产品的四倍，网络带宽是上一代产品的 2 倍，内存带宽是上一代产品的 1.5 倍，并提供 Mezz 卡、板载和 PCIe 三种形态。我们认为，AI 推动算力需求攀升，相关产业链有望持续受益。

投资建议：

本周我们继续看好受益算力芯片发展的玻璃基板产业链、受益于英伟达 GB200 的铜连接产业链、以先进封装为代表的半导体周期复苏主线、AI 为核心的算力芯片产业链。

玻璃基板：受益于算力芯片技术发展，产业链有望迎来加速成长，建议关注沃格光电、三超新材、德龙激光、帝尔激光、天承科技等；

铜连接：受益于英伟达 GB200 出货顺利，产业链需求有望增长，胜蓝股份、创益通、维峰电子、鼎通科技、立讯精密、神宇股份；

先进封装：受益于半导体大厂持续布局先进封装，产业链有望迎来加速成长，建议关注甬矽电子、中富电路、晶方科技、蓝箭电子等；

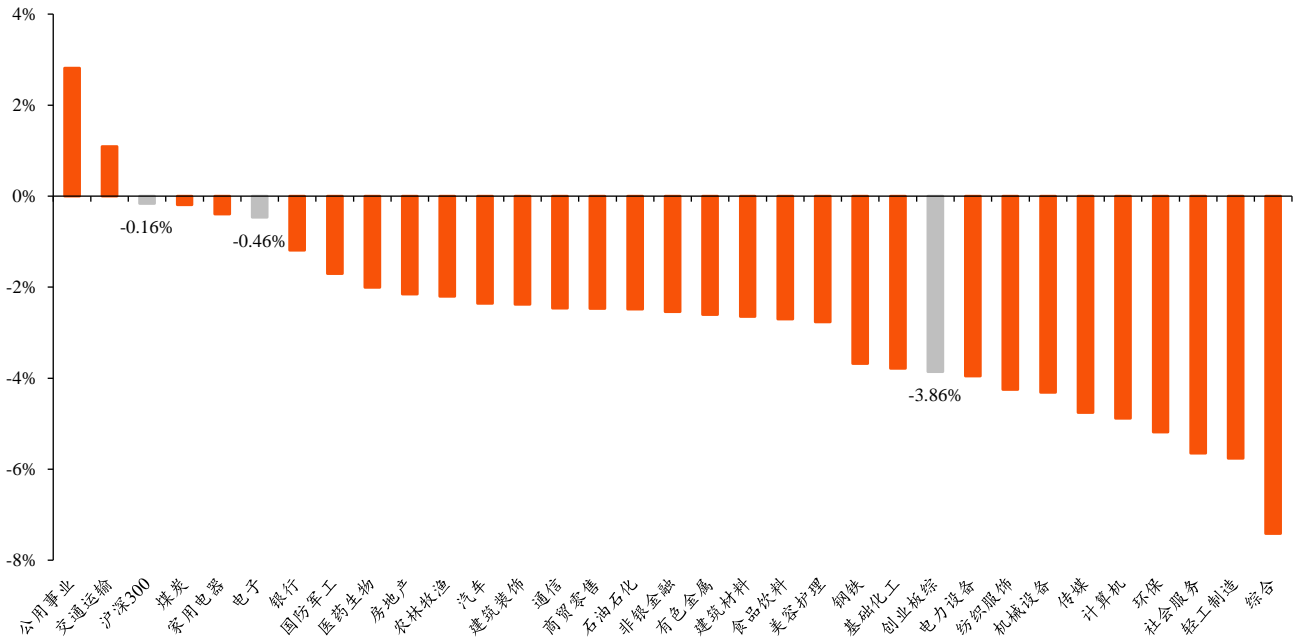
算力芯片：受益于算力需求持续攀升，有望带动上游算力芯片需求增长。建议关注寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等。

2. 市场回顾

2.1. 板块表现

本周（6.3-6.7），A 股申万电子指数下跌 0.46%，板块整体跑输沪深 300 指数 0.3pct，跑赢创业板综指数 3.39pct。在申万 31 个一级子行业中，电子板块周涨跌幅排名为第 5 位。

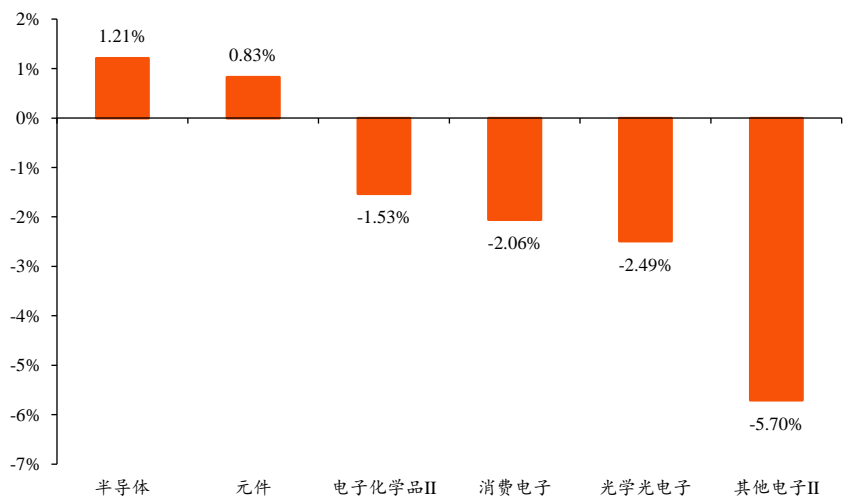
图1:A 股申万一级行业涨跌幅情况（6.03-6.07）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

本周（6.3-6.7）申万电子二级行业中，半导体板块上涨 1.21%，表现较好；其他电子 II 板块下跌 5.7%，表现较差。电子二级行业涨跌幅由高到低分别为：半导体(1.21%)、元件(0.83%)、电子化学品 II(-1.53%)、消费电子(-2.06%)、光学光电子(-2.49%)、其他电子 II(-5.7%)。

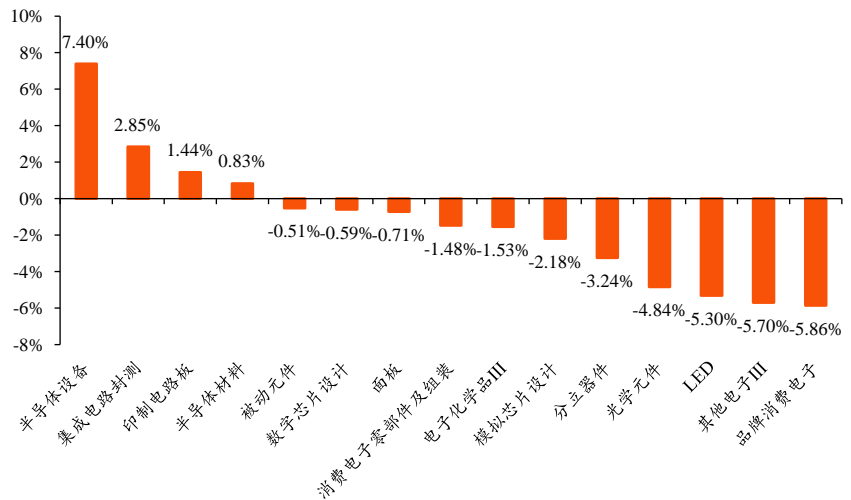
图2:A 股申万二级行业涨跌幅情况（6.03-6.07）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

本周（6.3-6.7）申万电子三级行业中，半导体设备板块上涨 7.4%，表现较好；品牌消费电子板块下跌 5.86%，表现较差。表现靠前的板块分别为：半导体设备(7.4%)、集成电路封测(2.85%)、印制电路板(1.44%)。表现靠后的板块分别为：品牌消费电子(-5.86%)、其他电子III(-5.7%)、LED(-5.3%)。

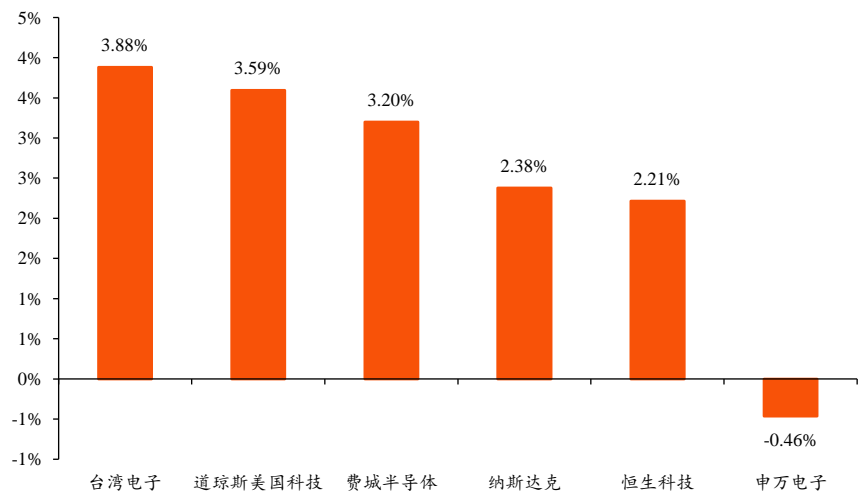
图3:A 股申万三级行业涨跌幅情况（6.03-6.07）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

从海外市场指数表现来看，整体继续维持强势。本周（6.3-6.7），海内外指数涨跌幅由高到低分别为：台湾电子(3.88%)、道琼斯美国科技(3.59%)、费城半导体(3.2%)、纳斯达克(2.38%)、恒生科技(2.21%)、申万电子(-0.46%)。

图4:海内外指数涨跌幅情况（6.03-6.07）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

2.1. 个股表现

本周（6.3-6.7）个股涨跌幅前十位分别为：协和电子（+61.09%）、逸豪新材（+54.66%）、贝仕达克（+50.67%）、中晶科技（+27.22%）、明阳电路（+22.09%）、金溢科技（+19.88%）、满坤科技（+17.01%）、四会富仕（+13.99%）、民德电子（+13.59%）、澳弘电子（+13.23%）。个股涨跌幅后十位分别为：*ST 碳元（-83.84%）、联建光电（-27.68%）、万祥科技（-27.42%）、英力股份（-26.97%）、光大同创（-23.23%）、超华科技（-22.99%）、ST 恒久（-22.89%）、福日电子（-20%）、隆扬电子（-19.27%）、ST 宇顺（-19.15%）。

表1:电子行业（申万）个股本周涨跌幅前后 10 名（6.03-6.07）

周涨跌幅前 10 名			周涨跌幅后 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
605258.SH	协和电子	61.09%	603133.SH	*ST 碳元	-83.84%
301176.SZ	逸豪新材	54.66%	300269.SZ	联建光电	-27.68%
300822.SZ	贝仕达克	50.67%	301180.SZ	万祥科技	-27.42%
003026.SZ	中晶科技	27.22%	300956.SZ	英力股份	-26.97%
300739.SZ	明阳电路	22.09%	301387.SZ	光大同创	-23.23%
002869.SZ	金溢科技	19.88%	002288.SZ	超华科技	-22.99%
301132.SZ	满坤科技	17.01%	002808.SZ	ST 恒久	-22.89%
300852.SZ	四会富仕	13.99%	600203.SH	福日电子	-20.00%
300656.SZ	民德电子	13.59%	301389.SZ	隆扬电子	-19.27%
605058.SH	澳弘电子	13.23%	002289.SZ	ST 宇顺	-19.15%

资料来源：Wind，甬兴证券研究所

3. 行业新闻

英特尔租用夏普闲置 LCD 面板厂，或将瞄准玻璃基板的面板级扇出型封装技术

6月7日消息，根据科创板日报援引中国台湾经济日报报道，英特尔携手14家日企合作，租用夏普闲置的LCD面板厂作为先进半导体技术研发中心，锁定后段封装领域，加码先进封装。业界认为，英特尔采用面板厂房作为基地，或将瞄准玻璃基板的面板级扇出型封装技术。

资料来源：(科创板日报)

英特尔 Gaudi 3 AI 芯片预估售价 15650 美元

6月7日消息，根据IT之家报道，英特尔在2024台北国际电脑展上，透露Gaudi 3 AI芯片售价为15650美元，基本上是英伟达H100芯片的一半。英特尔官方介绍称，新款Gaudi 3与英伟达H100相比训练性能提高了170%，推理能力提高了50%，效率提高了40%。英特尔全新Gaudi 3 AI加速器采用5nm工艺打造，FP8性能是上一代产品的两倍，BF16性能是上一代产品的四倍，网络带宽是上一代产品的2倍，内存带宽是上一代产品的1.5倍，并提供Mezz卡、板载和PCIe三种形态。

资料来源：(IT之家)

日月光锁定 AI 应用 推出 powerSiP™ 创新供电平台

6月7日消息，根据科创板日报报道，日月光锁定AI应用，推出powerSiP™创新供电平台，减少信号和传输损耗。日月光表示，powerSiP™技术创新可使电流密度增加50%，并将布线功耗从12%降低至6%，相较于传统并排配置的布线功耗降低了50%。业界认为，此技术直接对准数据中心效能和功耗改进要求。高效能运算(HPC)对于芯片需求，已由制程微缩转向封装堆叠，该技术强化日月光3D封装技术及未来营运表现，有助抢攻覆盖范围不断扩大的AI市场规模。

资料来源：(科创板日报)

GB200 采用 NVLink 技术，展现铜缆连接在高性能计算领域的潜力

3月29日消息，根据财联社报道，黄仁勋介绍，GB200采用72个Blackwell GPU全互连的NVLink技术，拥有超过2英里的NVLink铜缆，展现了铜缆连接在高性能计算领域的巨大潜力。英伟达此举是为了减少其数据中心设备的耗电量，使用铜而不是光学器件，可以为每个服务器机架节省20千瓦的电力。

资料来源：(财联社)

4. 公司动态

【钜泉科技】公司 BMS 芯片业务进展良好

6月6日消息，钜泉科技在投资者互动平台表示，公司研发的 AFE 芯片主要应用于动力二轮车、电动工具和家庭储能等领域，可支持多串电池包的应用，最多可扩展到 18 串。首颗工规级 AFE 芯片已完成研发，并进入客户送样测试阶段，并同步着手研发车规级 AFE 芯片，BMS 芯片实现量产后将给公司带来新的业绩贡献。

资料来源：（投资者互动平台）

【鸿合科技】作为出口型企业，公司海外仓的建设推动公司发展

6月4日消息，鸿合科技在投资者互动平台表示，公司海外自有品牌“Newline”继续发挥本土化运营、行业领先的软硬件产品以及产研一体化布局三大核心竞争优势，根据 Futuresource 报告显示，2024 年第一季度“Newline”在美国市场排名第一。未来公司将进一步发挥海外自有品牌的优势和影响力，加大新产品的开发与市场推进力度，进一步实现市场份额的突破。

资料来源：（投资者互动平台）

【闻泰科技】公司在车路云方面布局充分

6月6日消息，闻泰科技在投资者互动平台表示，公司是全球领先的基础半导体和产品集成企业，公司丰富的功率半导体和模拟 IC 产品广泛应用于包括车路云一体化系统在内的各类电子产品中，特别是车规级半导体器件，公司产品质量在全球处于领先水平；公司产品集成业务板块还有车端的智能座舱域控、自动驾驶域控、车载翻转屏、车载 T-BOX 等丰富车载产品线，部分产品已经批量供应给头部电动汽车品牌客户。

资料来源：（投资者互动平台）

5. 公司公告

表2:电子行业本周重点公告 (6.03-6.07)

日期	公司	公告类型	要闻
2024/06/03	拓荆科技	利润分配	公司 2023 年年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含税), 同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4.8 股, 股权登记日 2024 年 6 月 7 日, 除权除息日 2024 年 6 月 11 日。
2024/06/04	中船特气	利润分配	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 529,411,765 股为基数, 每股派发现金红利 0.19 元 (含税), 共计派发现金红利 100,588,235.35 元。
2024/06/04	复旦微电	利润分配	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 819,060,400 股为基数, 每股派发现金红利人民币 0.1 元 (含税), 共计派发现金红利 81,906,040 元。其中: A 股股本为 534,730,400 股, 共计派发现金红利 53,473,040 元; H 股股本为 284,330,000 股, 共计派发现金红利 28,433,000 元。
2024/06/05	协创数据	利润分配	以公司总股本 243,801,046 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元 (含税), 共派发现金红利 27,305,717.15 元 (含税)。本次利润分配不送红股, 不以资本公积金转增股本, 剩余未分配利润结转以后年度分配。
2024/06/06	燕东微	利润分配	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,199,104,111 股为基数, 每股派发现金红利 0.04 元 (含税), 共计派发现金红利 47,964,164.44 元 (含税)。

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

6. 风险提示

1) 中美贸易摩擦加剧的风险

未来若中美摩擦加剧，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

2) 下游终端需求不及预期的风险

未来若下游终端需求不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

3) 国产替代不及预期的风险

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。